

USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



USB 2.0 i 3.0 (SuperSpeed); złącza typu A spełniają wymagania dotyczące wysokiej wytrzymałości i zapewniają niezawodne połączenie.

- Maks. 5000 cykli wtykania
- Procesy lutowania THT, THR lub SMD
- Dostępne typy konstrukcji 180° (pionowa/stojąca) lub 90° (pozioma/leżąca)
- Pakowane albo na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)
- Wzmocniona warstwa złota dla lepszego zabezpieczenia przed korozją

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	OMNIMATE Data - gniazdo USB, listwa z gniazdami, 480 Mbps, Połączenie lutowane THT/THR, 180°, Raster w mm (P): 2.00 mm, Liczba biegunów: 4, LCP, czarny, Taca (montaż ręczny)
Nr zam.	2563730000
Typ	USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118572346
Ilość	100 Szt.
opakowanie	Taca (montaż ręczny)

Data sporządzenia 21 marca 2021 01:02:10 CET

USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	7,12 mm	Głębokość (cale)	0,28 inch
Masa netto	0,001 g	Najmniejsza wysokość montażu	15 mm
Szerokość	14,5 mm	Szerokość (cale)	0,571 inch
Wysokość	19,3 mm	Wysokość (cale)	0,76 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Właściwości elektryczne

Prąd znamionowy	1,5 A przy 250 V AC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	500 V AC
napięcie znamionowe	30 V		

Specyfikacje systemu

Długość pinu do lutowania (l)	2,9 mm	Ekranowanie	Tak
Klasa mocy	480 Mbps	LED	Nie
Liczba biegunów	4	Materiał ekranu	mosiądz
Powierzchnia ekranu	niklowany	Proces lutowania	Lutowanie rozpliwowe, Lutowanie ręczne, Lutowanie falowe
Raster w mm (P)	2 mm	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazdo USB	Siła ciągnięcia / biegun, maks.	10 N
Siła wtykania/biegun, maks.	35 N	Stopień ochrony	IP20
Szybkość przesyłania danych	480 Mbps	Zaciski ekranu	brak
kąt odejścia	180°	liczba kołków lutowanych na biegun	1
montaż na płytce drukowanej	Połączenie lutowane THT/ THR		

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	LCP	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	grupa materiałów izolacyjnych	II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	1
Klasa palności wg UL 94	V-0	podstawowy materiał styku	Fosforo-brąz
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Struktura warstwowa wtyku	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
Temperatura magazynowania, min.	-20 °C	Temperatura magazynowania, max.	60 °C
Temperatura pracy, min.	-20 °C	Temperatura pracy, max.	60 °C

Opakowanie

opakowanie	Taca (montaż ręczny)	Długość VPE	0 m
Szerokość VPE	0 m	Wysokość VPE	0 m

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

UL File Number Search

E471884

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

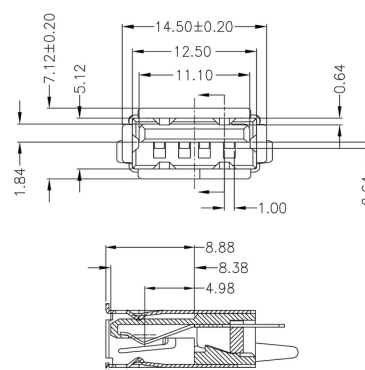
USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

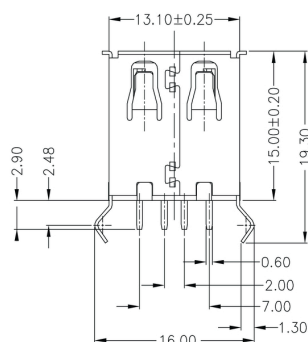
www.weidmueller.com

Rysunki

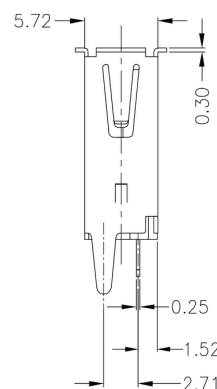
Rysunek wymiarowy



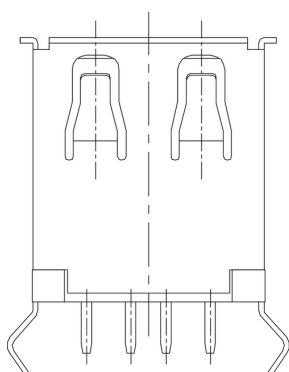
Rysunek wymiarowy



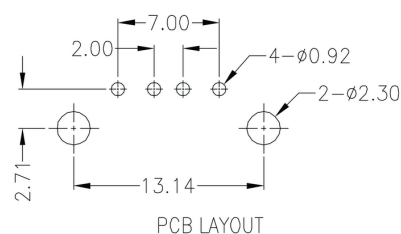
Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Układ płytek obwodu drukowanego



USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Legenda

USB	3.0A	R	1	V	3.0	N	4	TY	BL	USB3.0A R1V 3.0N4 TY BL

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

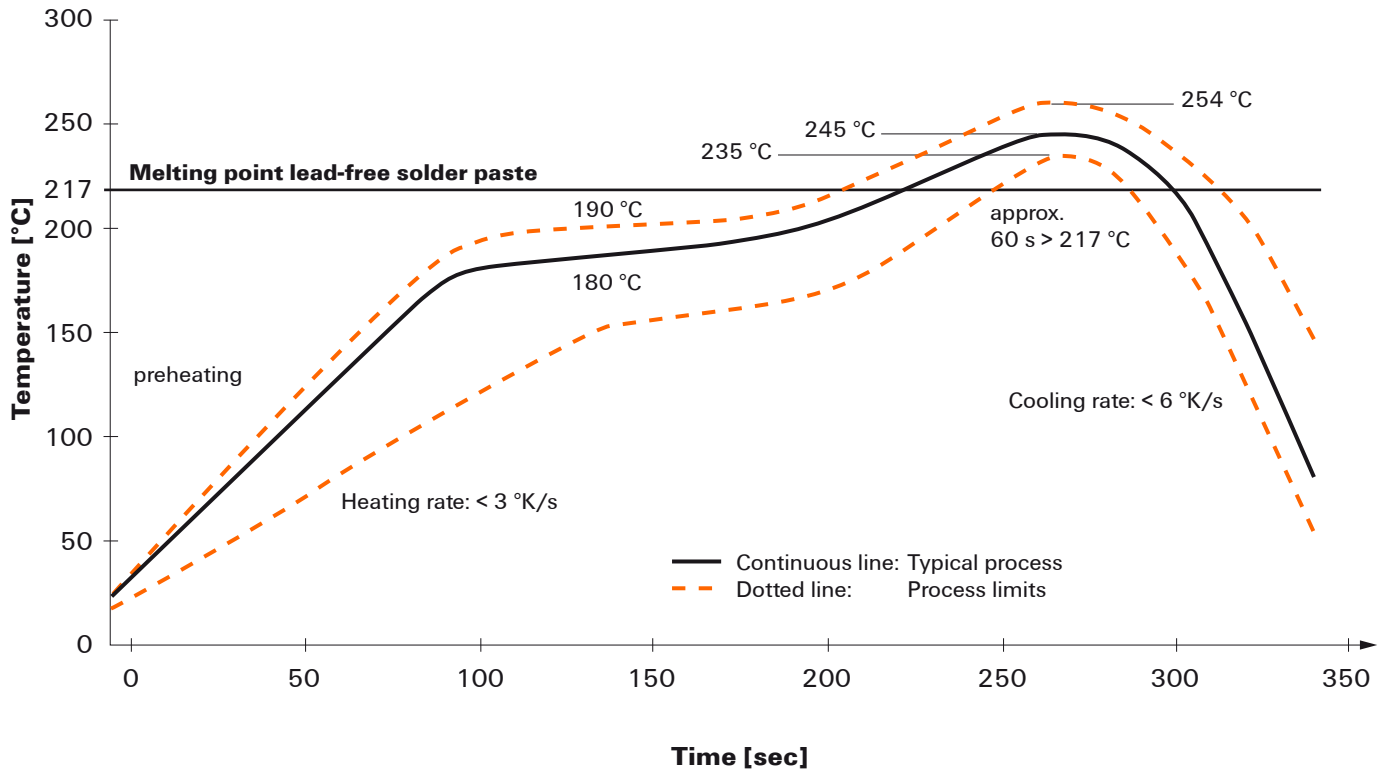
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.